

Inhalt

Seite

<i>E. Hamer</i>	Die deutsche Elektronikindustrie im internationalen Wettbewerb – Zukunft der Mittelstandsunternehmen	1
<i>D. Bergman</i>	Weltweite Technologietrends in der Leiterplattenindustrie	17
<i>R. Wagner</i>	Qualitätsmanagement und Integrierte Methodensysteme in Produktentwicklung, Fertigung und Marketing	29
<i>A. Angstenberger</i>	Höhere Produktivität durch fertigungsgerechtes Design	43
<i>D. G. Weiss</i>	Standardisierung kupferkaschierter Basismaterialien	63
<i>R. Schmider</i>	Standardisierung in der Leiterplattenfertigung – Standardzuschnitte	73

Podiumsdiskussion I Silberpasten

<i>St. M. Pfeifer</i>	Durchkontaktieren mit Silberleitpasten	83
<i>B. Rues</i>	Silber-durchkontaktierte Leiterplatten – ein Qualifizierungsprogramm	87

<i>G. Klink</i>	Wirksame QS-Systeme und die Anforderungen bei Zertifizierung auf der Grundlage der harmonisierten Normen DIN ISO-9000 ff./EN 29000 ff.	93
<i>A. U. Kasper</i>	Technologie der innenliegenden Kapazitäten	115
<i>H. Kuckelkorn</i>	Grundsätzliche Überlegungen zur Einführung eines Qualitätssicherungssystems	125
<i>E.-R. Mais</i>	Logistische und organisatorische Verfahren zur Optimierung der Durchlaufzeiten	151
<i>S. E. Kramer</i>	Lotperlen auf fotosensiblen Lötstopplacken – ein lösbares Problem (!)	167

Podiumsdiskussion II
Oberflächen für die Reflow-Lötung

<i>U. Biegel</i>	Einführung der SIPAD Oberfläche	185
<i>V. Clausen</i>	straschu High-Pad	191
<i>M. Hannemann</i>	Nickel-Gold/Anschlußflächen der Zukunft bei der Herstellung von Verdrahtungsstrukturen?	195
<i>G. Korsten</i>	Von HAL zu SSD	199
<i>A. Rahn, Ph.D.</i>	Ist Rein-Kupfer eine Oberflächenoption?	203
	Referenten, Diskussionsleiter und Programmausschuß	207
